

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，因此並未列載可能對閣下而言屬重要的所有資料，並應與本文件全文一併閱讀方屬完整。閣下決定投資[編纂]前，應閱讀整份文件。任何投資均涉及風險。投資於[編纂]的部分特定風險載於「風險因素」。閣下決定投資於[編纂]之前，應細閱該節。

概 覽

關於我們

我們是中國大陸領先先進IC封裝的IC載板供應商，專注於IC載板的研發、生產與銷售。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，我們為2025年中國大陸FCBGA載板市場及FCCSP載板市場最大的IC載板公司，市場份額分別為25.3%及13.4%；按收入計，我們亦為2025年中國大陸第二大IC載板公司，市場份額為12.5%。

我們的IC載板為連接半導體晶片與PCB的關鍵中間載體，實現晶片與外部電路之間的高密度電氣互連及高速信號傳輸，同時承擔物理固定與保護、機械支撐及促進散熱傳導等核心功能。我們的IC載板廣泛應用於AI服務器、高速運算、數據中心、智能設備、汽車電子及工業控制等下游領域，契合中國大陸半導體製造行業當前的升級趨勢。

我們的母公司台灣欣興電子自1997年進軍IC載板市場，於IC載板行業深耕近30年，具備深厚專業實力。作為全球領先的IC載板企業，台灣欣興電子按收入計已連續多年位居全球第一，我們亦依託其強大的技術實力。我們的蘇州生產基地為中國大陸首家於單一生產基地具備完整綜合型IC載板生產能力的製造商，可生產FCBGA載板、FCCSP載板及CSP載板全系列產品，便利客戶採購及我們開發複合技術新產品。我們的黃石生產基地負責FCBGA載板的前端生產工序，支援蘇州生產基地；我們亦於昆山興建第三座先進智能製造廠房。根據弗若斯特沙利文的資料，我們為首家專注協助中國大陸境內客戶實現FCBGA載板量產的企業。

我們秉持「深耕技術創新、維護生態環境、善盡社會責任、共築員工幸福」的核心使命，過去20年持續推進人才培育與技術創新。我們致力引領IC載板行業未來發展，成為產業價值鏈上各企業最值得信賴的合作夥伴。我們與主要供應商建立穩定長期的合作關係，確保原材料與設備供應的交期及品質穩定。

我們亦與中國大陸及國際領先的IC封裝及IC設計公司建立穩固長期的合作關係。於往績紀錄期間各年度，我們與大部分五大客戶的合作年期超過10年。我們積極參與客戶針對前沿應用需求的協同產品開發，推動聯合研發，鞏固長期穩定的業務合作。此外，我們的部分主要客戶已與我們簽訂產能承諾協議，客戶將預付保證金預留我們的產能，以緩解其潛在的物料供應短缺風險。

概 要

我們的產品

我們的IC載板分為FCBGA載板、FCCSP載板及CSP載板三類。於往績記錄期間，我們的收入主要來自FCBGA載板的銷售。下表載列於所示年度按產品類別劃分的我們IC載板製造及銷售的收入、銷量及平均售價明細：

	2023財年			2024財年			2025財年		
	收入	銷售量	單位 平均售價	收入	銷售量	單位 平均售價	收入	銷售量	單位 平均售價
	人民幣千元	千件	人民幣元/件	人民幣千元	千件	人民幣元/件	人民幣千元	千件	人民幣元/件
FCBGA載板	1,470,646	14,944	98.41	1,980,845	14,839	133.49	1,953,949	17,215	113.50
FCCSP載板	834,542	1,243,137	0.67	1,178,697	1,430,218	0.82	1,220,039	1,102,579	1.11
CSP載板	362,306	501,363	0.72	339,110	526,122	0.64	258,201	340,012	0.76
總計	<u>2,667,494</u>	<u>1,759,444</u>	1.52	<u>3,498,652</u>	<u>1,971,179</u>	1.77	<u>3,432,189</u>	<u>1,459,806</u>	2.35

由於產品的定制性質，我們的IC載板並無適用之固定或標準定價。定價乃根據產品規格(如尺寸及厚度)、設計與技術複雜程度、相關生產工序、所需原材料及生產成本、必要的行業認證及標準、客戶訂單數量以及市場狀況等多項因素而釐定。詳情請參閱「業務—我們的產品」。

研究與開發

我們相信，我們強大的研發能力與持續的技術創新，對於實現持續的行業領導地位及長期增長至關重要。截至2025年12月31日，我們擁有64項專利(包括22項發明專利及42項實用新型專利)，並已提交15項專利申請，其中10項已註冊專利及9項專利申請被視為對我們的業務屬重大。詳情請參閱「附錄五—B.有關我們業務的進一步資料—2.我們的重大知識產權」。該等專利主要涵蓋材料應用、關鍵製造工藝、結構設計及產品開發等領域。截至2025年12月31日，我們的研發團隊擁有超過500名員工，約60%的研發人員持有學士學位或更高學歷，涵蓋材料科學、工業工程、化學工程及電子信息等多個學科領域。

我們正致力於在IC載板方面取得各項研發突破，實現性能及可靠性的提升。FCBGA載板將朝著高頻高速傳輸產品、採用精密線路技術的產品、異質封裝產品以及具有更大尺寸、更高層數與纖薄設計的產品方向發展。FCCSP載板則將朝著更薄設計與精密線路技術的方向邁進。詳情請參閱「業務—研究與開發」。

生產

我們的蘇州生產基地建築面積超過174,000平方米，包括一個FCCSP/CSP載板生產設施及兩個FCBGA載板生產設施。我們的黃石生產基地建築面積超過50,000平方米，主要負責前端FCBGA載板的生產流程，以支持蘇州生產基地的生產作業。我們根據兩大生產流程主線製造產品：一種生產流程用於生產FCBGA載板，另一種生產流程用於生產FCCSP載板及CSP載板。由於產品的技術特性和規格不同，FCCSP/CSP載板生產設施和FCBGA載板生產設施之間的生產設備不可互換。我們的主要生產設備主要包括化學鍍銅生產線設備、光刻直接成像曝光設備、垂直連續銅鍍生產線設備、焊料微球安裝設備以及電子測試設備。詳情請參閱「業務—生產」。

概 要

銷售及營銷

我們採用直銷模式，且我們積極地與客戶進行合作式產品開發及產品驗證，詳情載於「業務 — 我們的業務模式」一節。於往績記錄期間，我們的IC載板主要銷售予中國大陸的IC封裝公司，其次銷售予IC設計公司。我們產品的下游客戶主要營運於AI服務器、高速運算、數據中心、智能設備、汽車電子及工業控制等領域。於2023財年、2024財年及2025財年，向我們五大客戶(其中包括餘下台灣欣興電子集團)銷售產生的收入分別為人民幣2,361.3百萬元、人民幣2,982.3百萬元及人民幣2,676.4百萬元，分別佔我們總收入的84.5%、81.5%及74.3%。詳情請參閱「與控股股東的關係」。於2023財年、2024財年及2025財年，來自我們最大客戶的收入分別佔各年度總收入的30.0%、33.0%及32.7%。

產能承諾

由於FCBGA載板的需求超出市場供應量，部分下游客戶已與我們簽訂產能承諾協議，並支付保證金以確保取得我們的產能，根據弗若斯特沙利文的資料，此做法符合業界常規。這些下游客戶通常透過我們的直接客戶採購產品。根據這些協議所支付的保證金可能為可退還或不可退還。詳情請參閱「業務 — 銷售及營銷 — 與客戶訂立的銷售合約的主要條款 — 產能承諾協議」。

不可退還的產能承諾按金與可退還部分的會計處理方式不同。該差異主要影響我們對收入、其他應付款項及應計費用以及合約負債的確認。對於不可退還產能承諾按金，按金於承諾期間構成一項重大權利。我們的客戶透過下達FCBGA載板訂單行使重大權利。所收取的保證金確認為合約負債，而相關收入則於承諾期間按比例確認。不可退還的產能承諾按金由於我們已收取全額款項且不會退還予下游客戶，因此對我們的流動性亦具有實際的現金影響。對於可退還產能承諾按金，所收取的保證金將按不計息基準分期退還予下游客戶，各期間退還金額分別按(i)對客戶銷售額之指定百分比計算金額，或(ii)已收取按金除以協議期內分期次數所得之固定金額確定。已收取按金之剩餘結餘(如有)須於最後一期悉數退還。可退還產能承諾按金初始按公平值計量，並計入其他應付款項及應計費用。初始公平值與所收取現金間之差額確認為合約負債，其後續計量方式與不可退還產能承諾按金相同。其後，可退還產能承諾按金按公平值計量，除歸因於信貸風險變動的公平值變動外，其餘變動金額於損益確認並計入其他虧損淨額。但由於確認可退還產能承諾項下的收入及費用並未為本集團帶來任何淨現金影響，因此不涉及任何現金流量影響。實際的現金影響將體現為：收取可退還產能承諾按金時的現金流入，以及將其退還給下游客戶時的現金流出。

於2023財年、2024財年及2025財年，我們來自不可退還產能承諾的收入分別為人民幣83.7百萬元、人民幣18.7百萬元及人民幣8.6百萬元，而來自可退還產能承諾的收入於各相關年度則分別為人民幣5.5百萬元、人民幣66.1百萬元及人民幣83.5百萬元。於2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日，來自產能承諾按金之合約負債分別為人民幣639.0百萬元、人民幣541.1百萬元及人民幣444.6百萬元。於2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日，其他應付款項及應計費用項下之可退還產能承諾按金分別為人民幣3,946.1百萬元、人民幣3,600.2百萬元及人民幣3,101.7百萬元。由於產能承諾收入源自已行使的重大權利，相關成本已分攤至FCBGA載板的生產及銷售環節，且並無直接歸屬於我們產能承諾的額外成本。故此，毛利等同於我們的產能承諾收入及產能承諾的毛利率為100%(供說明之用)。詳情請參閱「業務 — 銷售及營銷」及「業務 — 我們的客戶」。

概 要

供應及採購

我們生產IC載板的供應商包括(i)原材料供應商；(ii)機械及設備供應商；及(iii)部分生產及檢測流程的分包商。我們與該等供應商普遍維持穩定及長期的關係。於往績記錄期間，我們亦向餘下台灣欣興電子集團(於往績記錄期間各年度為我們的五大IC載板相關材料供應商之一)購買若干IC載板，再轉售予我們的客戶，詳情載於「與控股股東的關係—獨立於控股股東—與餘下台灣欣興電子集團的過往交易—我們向餘下台灣欣興電子集團購買IC載板」。我們的主要原材料主要包括銅箔、ABF、BT、覆銅板、半固化膠片及金屬材料(如金鹽)，主要採購自日本、中國大陸及南韓的供應商。我們主要向位於中國大陸、中國台灣、日本、德國及南韓的供應商採購生產機器及設備。於往績記錄期間，當我們相關流程的產能於特定時間滿載時，我們不時將鑽孔及出貨前檢驗等若干流程外包予專門從事該等流程的第三方承包商。詳情請參閱「業務—供應及採購」。

競爭格局

全球IC載板市場普遍呈現高度集中的競爭格局，產能及技術實力主要集中於中國台灣、日本及南韓等地區。相比之下，中國大陸對IC載板的市場需求迅速增長，支持本地製造商持續擴充產能並提升技術水平。從競爭結構角度來看，中國大陸的IC載板市場亦顯示出較高的集中度。尤其是，FCBGA載板分部的特點是具備規模化量產能力的市場參與者數目有限，導致龍頭企業的競爭優勢更為顯著。詳情請參閱「業務—競爭格局」。

競爭優勢

我們認為，以下競爭優勢不僅促進我們的成功，使我們從競爭對手中脫穎而出，更將推動我們的未來增長。

- 中國大陸市場領先的IC載板供應商，具備前瞻性技術優勢及多元化IC載板產品組合
- 與領先半導體企業建立穩固戰略合作及與主要客戶維持穩定關係
- 深厚的研發經驗與自主創新能力，維持行業領先的技術及生產工藝
- 完善智慧化及高度自動化生產流程支撐高品質量產
- 管理團隊於IC載板行業豐富的經驗與專業知識及賦能型企業文化，共同引領我們持續成長

我們的戰略

我們致力於進一步鞏固在中國大陸IC載板行業的領先地位，並力求透過以下戰略實現此目標。

- 通過設置額外生產設施擴充產能，提升智慧製造水準以應對快速增長的市場需求
- 持續投資技術研發，以增強長期差異化的技術優勢
- 強化人才引進與激勵機制，支持持續發展
- 強化與客戶的合作，鞏固行業領先地位

概 要

歷史及財務資料概要

下表列示我們的綜合財務數據概要，該等數據摘自我們於往績記錄期間的綜合損益表及綜合現金流量表，以及我們於2023年、2024年及2025年12月31日的綜合財務狀況表，該等財務報表載於附錄一會計師報告。以下數據及討論應與綜合財務報表及相關附註以及「財務資料」一節一併閱覽。

綜合損益表

	2023財年		2024財年		2025財年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
收入	2,794,138	100.0	3,659,025	100.0	3,602,676	100.0
銷售成本	(1,871,767)	(67.0)	(2,252,249)	(61.6)	(2,477,627)	(68.8)
毛利	922,371	33.0	1,406,776	38.4	1,125,049	31.2
其他收入	151,832	5.4	126,518	3.5	113,543	3.1
其他虧損淨額	(16,921)	(0.6)	(72,149)	(2.0)	(90,872)	(2.6)
銷售及分銷開支	(22,296)	(0.8)	(21,945)	(0.6)	(22,430)	(0.6)
行政開支	(96,351)	(3.4)	(109,255)	(3.0)	(124,149)	(3.4)
研發成本	(125,663)	(4.5)	(224,418)	(6.1)	(239,544)	(6.6)
貿易應收款項減值虧損撥回／(撥備)	6,356	0.2	(11,047)	(0.3)	2,340	*
經營溢利	819,328	29.3	1,094,480	29.9	763,937	21.1
財務成本	(15)	*	—	—	(1,114)	*
除稅前溢利	819,313	29.3	1,094,480	29.9	762,823	21.1
所得稅	(133,179)	(4.7)	(170,819)	(4.7)	(116,308)	(3.2)
年內溢利	686,134	24.6	923,661	25.2	646,515	17.9

* 表示比例低於0.1%

收入

於往績記錄期間，我們的收入主要來自：(A)有關IC載板的收入，包括(i)生產及銷售IC載板；(ii)產能承諾；(B)其他銷售，包括銷售生產餘料(主要包括金屬)；及(C)提供IC載板相關服務，包括向餘下台灣欣興電子集團提供貿易服務、加工及測試服務。下表載列所示期間按主要產品或服務類別劃分的收入明細：

	2023財年		2024財年		2025財年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
IC載板相關毛利						
— IC載板製造與銷售	2,667,494	95.5	3,498,652	95.6	3,432,189	95.3
— 產能承諾	89,188	3.2	84,810	2.3	92,066	2.6
IC載板相關毛利小計	2,756,682	98.7	3,583,462	97.9	3,524,255	97.9
其他銷售	32,628	1.2	63,834	1.7	63,264	1.8
服務收入	4,828	0.1	11,729	0.4	15,157	0.3
總計	2,794,138	100.0	3,659,025	100.0	3,602,676	100.0

概 要

毛利及毛利率

	2023 財年		2024 財年		2025 財年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
IC載板相關收入						
— IC載板製造與銷售	799,554	30.0	1,248,237	35.7	956,145	27.9
— 產能承諾	89,188	100.0	84,810	100.0	92,066	100.0
IC載板相關收入小計	888,742	32.2	1,333,047	37.2	1,048,211	29.7
其他銷售	31,022	95.1	62,315	97.6	61,681	97.5
服務收入	2,607	54.0	11,414	97.3	15,157	100.0
總計／整體	922,371	33.0	1,406,776	38.4	1,125,049	31.2

年度利潤

我們的年度利潤由2023財年的人民幣686.1百萬元增加人民幣237.5百萬元或34.6%至2024財年的人民幣923.7百萬元，主要由於我們的收入及毛利增加。我們的淨利潤率（年度利潤除以收入）保持相對穩定，2023財年及2024財年分別為24.6%及25.2%。我們的年度利潤由2024財年的人民幣923.7百萬元減少人民幣277.1百萬元或30.0%至2025財年的人民幣646.5百萬元，主要由於收入及毛利下降。我們的淨利潤率由2024財年的25.2%下降至2025財年的17.9%，主要由於毛利率下降。

綜合財務狀況表概要

	於12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總值	5,602,178	6,919,791	6,728,719
流動資產總值	5,416,880	3,739,052	3,341,922
流動負債總額	1,630,113	1,626,316	3,789,128
流動資產淨值／（負債淨額）	3,786,767	2,112,736	(447,206)
總資產減流動負債	9,388,945	9,032,527	6,281,513
淨資產	5,303,700	5,543,663	3,658,588

流動資產淨值／（負債淨額）

我們的流動資產淨值由2023年12月31日的人民幣3,786.8百萬元減少至2024年12月31日的人民幣2,112.7百萬元，主要由於定期存款及受限制銀行存款減少人民幣1,801.1百萬元，該款項用於支付收購同一控制下附屬公司權益的款項、應付股息以及收購非控股權益的付款。隨後，我們的流動資產淨值減少，於2025年12月31日轉為流動負債淨額人民幣447.2百萬元，主要由於：(i)其他應付款項及應計費用增加人民幣1,683.0百萬元，主要由於2025年12月31日應付股息增加人民幣1,523.6百萬元；(ii)現金及現金等價物減少人民幣651.9百萬元，主要由於支付股息，部分被經營活動所得現金所抵銷；及(iii)銀行貸款增加人民幣380.2百萬元。詳情請參閱「財務資料 — 綜合財務狀況表若干項目說明 — 其他應付款項及應計費用」。

概 要

綜合現金流量表概要

下表概述我們於所示期間的綜合現金流量表：

	2023 財年 人民幣千元	2024 財年 人民幣千元	2025 財年 人民幣千元
經營活動所得現金淨額	897,167	1,257,358	1,031,056
投資活動所用現金淨額	(2,543,042)	(4,651)	(403,914)
融資活動所得／(所用)得現金淨額	558,046	(1,193,580)	(1,278,759)
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(1,087,829)	59,127	(651,617)
年初現金及現金等價物	2,752,800	1,663,757	1,723,345
匯率變動的影響	(1,214)	461	(285)
年末現金及現金等價物	1,663,757	1,723,345	1,071,443

有關詳情，參見「財務資料—現金流量」。

於2023財年，我們的經營活動所得現金淨額為人民幣897.2百萬元，該金額已就非現金及非經營項目作出調整，主要包括(i)物業、廠房及設備折舊人民幣284.6百萬元；及(ii)利息收入人民幣126.3百萬元。該金額就已付所得稅人民幣244.8百萬元及營運資金變動作進一步調整。營運資金變動主要包括(i)貿易應收款項減少人民幣228.8百萬元；(ii)其他應付款項及應計費用下降人民幣143.9百萬元；(iii)合約負債下降人民幣150.3百萬元；及(iv)預付款項、按金及其他應收款項減少人民幣135.7百萬元。

於2024財年，我們的經營活動所得現金淨額為人民幣1,257.4百萬元，該金額已就非現金及非經營項目作出調整，主要包括(i)物業、廠房及設備折舊人民幣371.9百萬元；及(ii)利息收入人民幣95.3百萬元。該金額就已付所得稅人民幣79.5百萬元及營運資金變動作進一步調整。營運資金變動主要包括(i)其他應付款項及應計費用減少人民幣44.2百萬元；(ii)庫存增加人民幣87.0百萬元；及(iii)合約負債減少人民幣95.2百萬元。

於2025財年，我們的經營活動所得現金淨額為人民幣1,031.1百萬元，該金額已就非現金及非經營項目作出調整，主要包括(i)物業、廠房及設備折舊人民幣437.8百萬元；及(ii)利息收入人民幣86.8百萬元。該金額就已付所得稅人民幣192.5百萬元及營運資金變動作進一步調整。營運資金變動主要包括貿易應付款項增加人民幣86.0百萬元。

近期發展及無重大不利變動

截至2026年4月30日止四個月，我們分別售出約7.6百萬元FCBGA載板、371.3百萬元FCCSP載板及137.2百萬元CSP載板，較截至2025年4月30日止四個月各類產品的銷量分別增加92.5%、6.3%及54.6%。

自2026年1月1日起至最後實際可行日期，我們已：

- 就生產廠房之擴建／升級而言，生產FCBGA載板的蘇州生產廠房的新設備目前正在安裝及測試中，預計測試與調校將於2026年6月底前完成；且我們mSAP產品的FCCSP載板新生產線已經下游客戶驗證，該生產線已於2025財年展開樣本生產，並於2026年1月量產；及
- 就研發而言：

概 要

- 關於我們的FCBGA載板技術開發：(1)我們一直致力於開發適用於高頻及高速應用的高性能ABF介電材料，我們亦一直開發及驗證可替代ABF的國產材料，並已完成初步驗證，生產參數及良率正在改善；及(2)我們亦一直致力於開發配備IPD及多層芯板的FCBGA基板。兩者的結構驗證均已告完成，且我們目前正與下游客戶商討產品樣本的規格及結構；及
- 關於我們透過引入新材料推出薄型FCCSP的舉措：我們一直進行測試，並正與下游客戶商討產品樣本的規格及結構。關於我們開發精細(即10/10 um)線路能力及更高設計密度的研發舉措：我們利用高精度成像技術以提升成像解析度及優化線路佈局，一直對相關IC載板的技術難點進行測試及驗證，並進行試產，同時評估量產需求。

董事確認，自2025年12月31日(即我們最新綜合財務報表的結算日)起至本文件日期，我們的財務或經營狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年12月31日起並未發生將對本文件附錄一所載會計師報告中所示資料產生重大影響的事件。

[編纂]統計數據

下表所呈列的所有統計數字乃假設[編纂]未獲行使：

	基於[編纂] 每股H股[編纂]港元	基於[編纂] 每股H股[編纂]港元
緊隨[編纂]完成後股份的市值 ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
本公司權益股東應佔未經審核[編纂]		
整綜合每股股份有形資產淨值 ⁽²⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- 該計算乃假設[編纂]股H股預期將於緊隨[編纂]完成後發行，並假設[編纂]未獲行使。
- 每股本公司權益股東應佔未經審核[編纂]每股有形資產淨值乃經本文件附錄二「未經審核[編纂]財務資料」所述調整後，並以緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股H股為基準且假設[編纂]未獲行使計算。

股息政策

於往績記錄期間，我們分別於2023財年、2024財年及2025財年向股東宣派股息人民幣零元、人民幣190.0百萬元及人民幣2,800.0百萬元。宣派股息須由董事會酌情決定及經股東批准。董事日後亦可於考慮我們的營運及盈利、資本要求及盈餘、整體財務狀況、合約限制、資本開支及未來發展需要、股東權益及其當時視為相關的其他因素後建議派付股息。任何擬派股息均須經董事會酌情決定並於股東大會上批准。任何未來股息宣派不一定會反映我們過往的股息宣派及將由董事全權酌情釐定。詳情請參閱「財務資料—股息政策」。

概 要

我們的控股股東

於[編纂]後，台灣欣興電子、UniBest、Hemingway、UMTC、UniWonderful、UHL及蘇州群曄將為本公司的控股股東。UHL將直接持有我們已發行股份約[編纂]%。UHL由台灣欣興電子持有約89.43%及由LD Taiwan持有約10.57%。詳情請參閱「與控股股東的關係」。

誠如我們的中國台灣法律顧問所告知，毋須就[編纂]獲得台灣欣興電子的監管批准且我們已就[編纂]獲得所有台灣欣興電子所需的公司批准。

我們在中國大陸設計、開發及製造IC載板，並主要向在中國大陸成立的客戶銷售產品。另一方面，餘下台灣欣興電子集團主要製造、加工及銷售印刷電路板、電工器材、電子產品以及IC產品測試與預燒系統之製造，並於往績記錄期間，IC載板主要與在中國大陸以外註冊成立或設立的客戶訂立合約，且向彼等銷售產品。[編纂]後，除不競爭契據所載情況外，餘下台灣欣興電子集團將不會向在中國大陸成立的客戶銷售IC載板，亦不會從事任何與我們業務競爭或可能競爭的業務。

於往績記錄期間，我們與餘下台灣欣興電子集團訂立了若干交易，我們預計有關交易（「關連交易」章節所述者除外）於[編纂]前停止。於2023財年、2024財年及2025財年，我們來對餘下台灣欣興電子集團銷售應佔的收入分別為人民幣838.7百萬元、人民幣616.0百萬元及人民幣358.4百萬元，分別佔我們相應年度收入的30.0%、16.8%及9.9%；而我們向餘下台灣欣興電子集團採購IC載板相關材料的金額分別為人民幣79.8百萬元、人民幣210.6百萬元及人民幣347.5百萬元，分別佔我們相應年度IC載板相關材料採購總額的9.1%、13.7%及20.3%。我們[已訂立]並預期將於[編纂]後繼續進行若干交易，該等交易於[編纂]後將構成[編纂]項下本公司的持續關連交易。有關該部分獲豁免持續關連交易及豁免的詳情載於「關連交易」。詳情請參閱「與控股股東的關係—與餘下台灣欣興電子集團的過往交易」。

[編纂]

按[編纂]每股H股[編纂]港元計算，與[編纂]相關的估計[編纂]總額為人民幣[編纂]元（[編纂]港元）（假設[編纂]未獲行使）。我們的[編纂]總額包括(i)[編纂]相關開支及費用（包括[編纂]佣金、聯交所交易費、證監會及會財局交易徵費）人民幣[編纂]元（[編纂]港元）；及(ii)非[編纂]相關開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元），包括(a)應付獨家保薦人、法律顧問及申報會計師的費用人民幣[編纂]元（[編纂]港元）及(b)其他費用及開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元）。[編纂]總額中，人民幣[編纂]元預期將於[編纂]損益中扣除，而發行H股直接應佔人民幣[編纂]元預期將於[編纂]完成後自權益中扣除。上述[編纂]開支為最新實際可行估計，僅供參考，實際金額可能與該估計有所不同。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即[編纂]範圍的[編纂]），經扣除[編纂]、費用及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們估計將自[編纂]獲得[編纂]淨額約[編纂]港元。我們目前擬將該等[編纂]淨額按下文所列金額用於以下擬定用途：

- 約[編纂]港元，佔所得款項淨額的[編纂]%，預期將用於擴大及升級我們的蘇州及黃石生產基地，以及在我們的昆山生產廠建立生產設施，進而擴大我們FCBGA載板的產能；

概 要

- 約[編纂]港元，佔[編纂]淨額的[編纂]%，預期將用於進一步加強我們的技術研發能力；及
- 約[編纂]港元，佔[編纂]淨額的[編纂]%，預期將用作我們的一般營運資金。

詳情請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

風險因素

我們的運營及[編纂]涉及若干風險及不確定因素，其乃載於本文件「風險因素」一節。閣下決定[編纂]於我們的股份前，應細閱該章節的全部內容。我們面臨的部分主要風險包括：

- 我們的業務表現及前景取決於我們能否持續創新、提升技術能力及產品。
- 我們的表現取決於使用我們產品的下游行業的需求。下游行業增長放緩可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。客戶對不同類型IC載板的需求的變化亦會影響我們按產品類別劃分的銷售構成，從而可能影響我們的利潤率及經營業績。
- 我們收入的很大部分來自我們的主要客戶及我們向其中任何一方的銷售減少或終止，可能對我們業務及財務狀況造成重大不利影響。
- 我們的生產過程複雜。生產線的中斷及暫停可能嚴重影響我們的產量，進而影響我們的業務、財務狀況及經營業績。
- 我們過去與若干下游客戶簽訂的產能承諾協議已收到大額保證金。若我們未能履行該等協議下的承諾，我們將被要求退還該等保證金及／或支付賠償金，這將對我們的財務狀況及經營業績造成重大不利影響。